



2018年11月8日

各 位

会 社 名 イノテック株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 小野 敏彦
(コード：9880 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 棚橋 祥紀
(TEL：045-474-9000)

ブイ・テクノロジーとの業務提携、および Z-CSET への 資本参加に関するお知らせ

イノテック株式会社（本社：横浜市港北区、代表者：小野 敏彦、以下当社）は、本日の取締役会において、株式会社ブイ・テクノロジー（本社：横浜市保土ヶ谷区、代表者：杉本 重人、以下ブイ・テクノロジー）と中国における半導体メモリー用テスター事業について業務提携を行うこと、およびブイ・テクノロジー、海寧市嘉勤投資有限公司（本社：浙江省海寧市、代表者：呉 洪峰）、海寧瑞美科技有限公司（本社：浙江省海寧市、代表者：嚴 永芬）との合弁会社である浙江芯暉設備技術有限公司（本社：浙江省海寧市、代表者：楊 兆明、以下 Z-CSET）へ資本参加することについて基本合意することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、Z-CSET への資本参加につきましては、ブイ・テクノロジーが保有する Z-CSET 出資分の一部を当社が有償で譲り受けることで、当社とブイ・テクノロジーで基本合意いたしました。

記

1. 資本業務提携の理由

当社の主要ビジネスであるテスター事業を中国市場へ展開させることは、当社の中期的な成長を実現するための重要事項と考えております。

ブイ・テクノロジーは、半導体製造装置関連事業を中国市場に展開する目的で Z-CSET を設立しており、当社が両社と提携することにより、急速に発展している中国半導体市場において当社テスター事業の拡大を図るものです。

2. 資本業務提携の内容

当社が Z-CSET に対し製品化のための技術支援や部品供給などを行い、Z-CSET が製品の組み立て、販売、アフターサポートを行う予定です。当社から Z-CSET への部品供給は、ブイ・テクノロジー経由で行います。また、中国市場におけるテスター事業を推進するため、当社はブイ・テクノロジーが保有する Z-CSET の出資分の一部（10%）を有償で譲り受けることにより関係強化を図ります。

3. 業務提携の相手先の概要

(1)	名 称	株式会社ブイ・テクノロジー		
(2)	所 在 地	〒240-0005 横浜市保土ヶ谷区神戸町 134		
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長：杉本 重人		
(4)	事 業 内 容	1. フラットパネルディスプレイ用、製造装置、検査装置、測定装置、観察装置および修正装置の開発・製造・販売・サービス 2. 太陽電池・LED 向け装置の開発・販売		
(5)	資 本 金	2,831 百万円		
(6)	設 立 年 月 日	1997 年 10 月 16 日		
(7)	大株主及び持株比率	杉本 重人：11.86% CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW：7.47% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）：4.15% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）：3.88% BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED：2.11% (2018 年 3 月 31 日現在)		
(8)	上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	該当事項はありません。	
		人 的 関 係	該当事項はありません。	
		取 引 関 係	該当事項はありません。	
		関連当事者への該当状況	該当事項はありません。	
(9)	当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態			
	決 算 期	2016 年 3 月期	2017 年 3 月期	2018 年 3 月期
	連 結 純 資 産	9,387 百万円	13,796 百万円	21,114 百万円
	連 結 総 資 産	37,183 百万円	47,563 百万円	64,786 百万円
	1 株 当 たり 連 結 純 資 産	1,905.37 円	2,469.20 円	3,865.50 円
	連 結 売 上 高	39,153 百万円	45,376 百万円	66,067 百万円
	連 結 営 業 利 益	2,578 百万円	5,414 百万円	12,545 百万円
	連 結 経 常 利 益	2,235 百万円	5,406 百万円	12,370 百万円
	親会社株主に帰属する当期純利益	989 百万円	2,813 百万円	7,837 百万円
	1 株 当 たり 連 結 当 期 純 利 益	209.46 円	577.48 円	1,582.84 円
	1 株 当 たり 配 当 金	50.00 円	115.00 円	270.00 円

4. 合併会社の概要(出資後)

(1) 名称	浙江芯暉設備技術有限公司 (Zhejiang Chip Sunshine Equipment Technology Co., Ltd.)
(2) 所在地	浙江省嘉興市海寧市海寧經濟開發區隆興路 118 号内メイン事務棟 3 階 370 室
(3) 代表者の役職・氏名	総経理：楊 兆明
(4) 事業内容	半導体製造装置、半導体ウェハ－研磨関連装置、および部品の研究開発・生産・販売と関連する業務、技術開発・技術移転・技術コンサルタントと技術サービス、製品の輸出入・技術の輸出入・輸出入の代理業務、およびそれらの業務に付帯する一切の業務
(5) 資本金	12 百万 USD
(6) 出資比率	海寧市嘉勤投資有限公司：55% 株式会社ブイ・テクノロジー：30% イノテック株式会社：10% 海寧瑞美科技有限公司：5%

5. 日程

(1) 取締役会決議日	2018 年 11 月 8 日
(2) 出資分の譲受日	2018 年 11 月 (予定)
(3) 業務提携契約締結日	2018 年 11 月 (予定)

6. 今後の見通し

本件業務提携による 2019 年 3 月期の業績への影響は軽微ですが、中長期的には企業業績の向上に繋がるものと考えております。今後、公表すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。

以上